



半導体部品の管理向上のご提案 - 製造・輸送・使用過程 -

スマートフォン、デジタルカメラ、パソコン、家電製品、自動車部品など様々な分野・用途で活用される半導体製品は、製造環境の品質担保が非常に重要です。

また、製造後、輸送中や製品使用中に落下衝撃事象に遭遇し、破損に至る可能性があります。

このようなトラブルを予防するために、半導体部品の製造環境の管理および開発・設計段階で、耐衝撃性能に関する仕様を決定しておき、それが満足していることを確認するための落下・衝撃試験を実施することが求められます。

神栄テクノロジーでは、半導体部品の品質管理、および落下衝撃に対する製品強度向上を行うことで市場でのトラブル予防に貢献する製品をと製造・販売しています。

パーティクルセンシングモニター AES-FP シリーズ



清浄度管理が必要な環境で $0.3\mu\text{m}$ (もしくは $0.5\mu\text{m}$) 以上の粒子の常時監視ができます。

【特長】

- ・各工程や室内環境での発塵、異常イベントを常時モニタリング。
- ・重点管理ポイントに複数設置してネットワークを組む事で工程内の清浄度の一括管理が可能。
- ・温湿度センサ(別売)への接続が可能。

【主な用途】

半導体製造工程での清浄度および温湿度管理

[製品情報を詳しく見る](#)

[製品について問い合わせる](#)

軽量落下試験機 DT-202



実際に製品使用中に起きる落下事象を想定し、半導体製品そのものに対する落下耐久性を確認可能。

【特長】

- ・供試品保持落下機構により、繰り返し精度の高い落下試験を実現。
- ・落下高さ範囲 25cm～2m まで任意に調整可能。
- ・誰でも簡単に落下試験ができるシンプル操作。

【主な用途】

半導体部品の落下破損試験に。

[製品情報を詳しく見る](#)

[製品について問い合わせる](#)

衝撃試験装置 PDST シリーズ



最大加速度 数千 G 以上の高衝撃加速度試験が可能。

【特長】

- ・衝撃台の強制落下機構により、高い速度変化(最大 15m/s)の衝撃パルスが発生可能。
- ・高加速度発生装置により、最大 $300,000\text{m/s}^2$ (30,000G) が発生可能。
- ・高精度/高再現性の正弦半波パルス。

【主な用途】

半導体製品自体に指定の衝撃加速度を印加し、耐衝撃性能を数値管理。

[製品情報を詳しく見る](#)

[製品について問い合わせる](#)